

**第一节 重要提示**

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当将相关内容刊登在www.sse.com.cn网站上仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示  
公司在经营过程中面临的各种风险，敬请查阅年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，敬请投资者注意。

3. 本年度报告中，董事会、监事会、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构、会计师事务所等承诺年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

4. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 公司、监事未及监事均未实施股权激励。

6. 公司、监事未及监事均未实施股权激励。

7. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制评价报告出具了无保留意见的审计报告。

8. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制评价报告出具了无保留意见的审计报告。

# 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

## 2022 年度报告摘要

较高的增长，由点带动，进而辐射到片市场需求稳定增长。  
3. 公司主要业务板块和财务指标  
3.1 近五年的主要业务数据和财务指标

单位/元	2022年	2021年	同比增/减	2020年
营业收入	4,151,377,981.38	3,441,045,258.26	20.66%	1,894,223,960.30
归属于上市公司股东的净利润	3,766,627,021.94	3,176,452,692.29	15.43%	2,675,767,162.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,795,623,926.96	1,326,549,608.93	35.40%	666,498,617.24
经营活动产生的现金流量净额	369,867,410.61	443,528,363.13	-16.98%	167,768,136.59
归属于上市公司股东的净资产	107,234,074.62	399,991,312.62	-72.47%	167,268,967.38
归属于上市公司股东的总资产	539,302,902.24	841,741,671.03	-35.70%	239,349,943.93
归属于上市公司股东的每股净资产	7.79	16.57	减少52.40%	21.37
基本每股收益	2.23	3.72	-40.06%	1.00
稀释每股收益	2.23	3.72	-40.06%	1.00
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.37	-21.62%	0.15
归属于上市公司股东的净资产	36.76	23.71	增加54.63%	21.63

单位/元	2022年	2021年	同比增/减	2020年
归属于上市公司股东的净资产	443,928,020.00	959,603,648.00	-53.53%	679,300,000.00
归属于上市公司股东的总资产	91,409,012.38	143,613,418.89	-36.31%	72,481,724.88
归属于上市公司股东的每股净资产	72.42	129.00	减少42.62%	29.37
每股经营活动产生的现金流量净额	196.51	197.94	-0.72%	102.58

2022年度主要业务数据和财务指标  
2022年度主要业务数据和财务指标  
2022年度主要业务数据和财务指标

1. 公司简介  
1.1 公司概况  
1.2 公司主要业务  
1.3 公司主要产品

股票简称	股票代码	上市交易所	成立日期	注册地址	办公地址
思瑞浦	688336	上海证券交易所科创板	2021年11月11日	苏州市工业园区金鸡湖大道1318号思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司总部大楼	苏州市工业园区金鸡湖大道1318号思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司总部大楼

2. 公司主要业务  
2.1 集成电路设计  
2.2 集成电路制造  
2.3 集成电路封装

3. 公司主要产品  
3.1 集成电路设计  
3.2 集成电路制造  
3.3 集成电路封装

4. 公司主要业务  
4.1 集成电路设计  
4.2 集成电路制造  
4.3 集成电路封装

5. 公司主要产品  
5.1 集成电路设计  
5.2 集成电路制造  
5.3 集成电路封装

6. 公司主要业务  
6.1 集成电路设计  
6.2 集成电路制造  
6.3 集成电路封装

7. 公司主要产品  
7.1 集成电路设计  
7.2 集成电路制造  
7.3 集成电路封装

8. 公司主要业务  
8.1 集成电路设计  
8.2 集成电路制造  
8.3 集成电路封装

9. 公司主要产品  
9.1 集成电路设计  
9.2 集成电路制造  
9.3 集成电路封装

10. 公司主要业务  
10.1 集成电路设计  
10.2 集成电路制造  
10.3 集成电路封装

11. 公司主要产品  
11.1 集成电路设计  
11.2 集成电路制造  
11.3 集成电路封装

12. 公司主要业务  
12.1 集成电路设计  
12.2 集成电路制造  
12.3 集成电路封装

13. 公司主要产品  
13.1 集成电路设计  
13.2 集成电路制造  
13.3 集成电路封装

14. 公司主要业务  
14.1 集成电路设计  
14.2 集成电路制造  
14.3 集成电路封装

15. 公司主要产品  
15.1 集成电路设计  
15.2 集成电路制造  
15.3 集成电路封装

16. 公司主要业务  
16.1 集成电路设计  
16.2 集成电路制造  
16.3 集成电路封装

17. 公司主要产品  
17.1 集成电路设计  
17.2 集成电路制造  
17.3 集成电路封装

18. 公司主要业务  
18.1 集成电路设计  
18.2 集成电路制造  
18.3 集成电路封装

19. 公司主要产品  
19.1 集成电路设计  
19.2 集成电路制造  
19.3 集成电路封装

20. 公司主要业务  
20.1 集成电路设计  
20.2 集成电路制造  
20.3 集成电路封装

21. 公司主要产品  
21.1 集成电路设计  
21.2 集成电路制造  
21.3 集成电路封装

22. 公司主要业务  
22.1 集成电路设计  
22.2 集成电路制造  
22.3 集成电路封装

23. 公司主要产品  
23.1 集成电路设计  
23.2 集成电路制造  
23.3 集成电路封装

24. 公司主要业务  
24.1 集成电路设计  
24.2 集成电路制造  
24.3 集成电路封装

25. 公司主要产品  
25.1 集成电路设计  
25.2 集成电路制造  
25.3 集成电路封装

26. 公司主要业务  
26.1 集成电路设计  
26.2 集成电路制造  
26.3 集成电路封装

27. 公司主要产品  
27.1 集成电路设计  
27.2 集成电路制造  
27.3 集成电路封装

28. 公司主要业务  
28.1 集成电路设计  
28.2 集成电路制造  
28.3 集成电路封装

29. 公司主要产品  
29.1 集成电路设计  
29.2 集成电路制造  
29.3 集成电路封装

30. 公司主要业务  
30.1 集成电路设计  
30.2 集成电路制造  
30.3 集成电路封装

31. 公司主要产品  
31.1 集成电路设计  
31.2 集成电路制造  
31.3 集成电路封装

32. 公司主要业务  
32.1 集成电路设计  
32.2 集成电路制造  
32.3 集成电路封装

33. 公司主要产品  
33.1 集成电路设计  
33.2 集成电路制造  
33.3 集成电路封装

34. 公司主要业务  
34.1 集成电路设计  
34.2 集成电路制造  
34.3 集成电路封装

35. 公司主要产品  
35.1 集成电路设计  
35.2 集成电路制造  
35.3 集成电路封装

36. 公司主要业务  
36.1 集成电路设计  
36.2 集成电路制造  
36.3 集成电路封装

37. 公司主要产品  
37.1 集成电路设计  
37.2 集成电路制造  
37.3 集成电路封装

38. 公司主要业务  
38.1 集成电路设计  
38.2 集成电路制造  
38.3 集成电路封装

39. 公司主要产品  
39.1 集成电路设计  
39.2 集成电路制造  
39.3 集成电路封装

40. 公司主要业务  
40.1 集成电路设计  
40.2 集成电路制造  
40.3 集成电路封装

41. 公司主要产品  
41.1 集成电路设计  
41.2 集成电路制造  
41.3 集成电路封装

42. 公司主要业务  
42.1 集成电路设计  
42.2 集成电路制造  
42.3 集成电路封装

43. 公司主要产品  
43.1 集成电路设计  
43.2 集成电路制造  
43.3 集成电路封装

44. 公司主要业务  
44.1 集成电路设计  
44.2 集成电路制造  
44.3 集成电路封装

45. 公司主要产品  
45.1 集成电路设计  
45.2 集成电路制造  
45.3 集成电路封装

46. 公司主要业务  
46.1 集成电路设计  
46.2 集成电路制造  
46.3 集成电路封装

47. 公司主要产品  
47.1 集成电路设计  
47.2 集成电路制造  
47.3 集成电路封装

48. 公司主要业务  
48.1 集成电路设计  
48.2 集成电路制造  
48.3 集成电路封装

49. 公司主要产品  
49.1 集成电路设计  
49.2 集成电路制造  
49.3 集成电路封装

50. 公司主要业务  
50.1 集成电路设计  
50.2 集成电路制造  
50.3 集成电路封装

51. 公司主要产品  
51.1 集成电路设计  
51.2 集成电路制造  
51.3 集成电路封装

52. 公司主要业务  
52.1 集成电路设计  
52.2 集成电路制造  
52.3 集成电路封装

53. 公司主要产品  
53.1 集成电路设计  
53.2 集成电路制造  
53.3 集成电路封装

54. 公司主要业务  
54.1 集成电路设计  
54.2 集成电路制造  
54.3 集成电路封装

55. 公司主要产品  
55.1 集成电路设计  
55.2 集成电路制造  
55.3 集成电路封装

56. 公司主要业务  
56.1 集成电路设计  
56.2 集成电路制造  
56.3 集成电路封装

57. 公司主要产品  
57.1 集成电路设计  
57.2 集成电路制造  
57.3 集成电路封装

58. 公司主要业务  
58.1 集成电路设计  
58.2 集成电路制造  
58.3 集成电路封装

59. 公司主要产品  
59.1 集成电路设计  
59.2 集成电路制造  
59.3 集成电路封装

60. 公司主要业务  
60.1 集成电路设计  
60.2 集成电路制造  
60.3 集成电路封装

61. 公司主要产品  
61.1 集成电路设计  
61.2 集成电路制造  
61.3 集成电路封装

62. 公司主要业务  
62.1 集成电路设计  
62.2 集成电路制造  
62.3 集成电路封装

63. 公司主要产品  
63.1 集成电路设计  
63.2 集成电路制造  
63.3 集成电路封装

64. 公司主要业务  
64.1 集成电路设计  
64.2 集成电路制造  
64.3 集成电路封装

65. 公司主要产品  
65.1 集成电路设计  
65.2 集成电路制造  
65.3 集成电路封装

66. 公司主要业务  
66.1 集成电路设计  
66.2 集成电路制造  
66.3 集成电路封装

67. 公司主要产品  
67.1 集成电路设计  
67.2 集成电路制造  
67.3 集成电路封装

68. 公司主要业务  
68.1 集成电路设计  
68.2 集成电路制造  
68.3 集成电路封装

69. 公司主要产品  
69.1 集成电路设计  
69.2 集成电路制造  
69.3 集成电路封装

70. 公司主要业务  
70.1 集成电路设计  
70.2 集成电路制造  
70.3 集成电路封装

71. 公司主要产品  
71.1 集成电路设计  
71.2 集成电路制造  
71.3 集成电路封装

72. 公司主要业务  
72.1 集成电路设计  
72.2 集成电路制造  
72.3 集成电路封装

73. 公司主要产品  
73.1 集成电路设计  
73.2 集成电路制造  
73.3 集成电路封装

74. 公司主要业务  
74.1 集成电路设计  
74.2 集成电路制造  
74.3 集成电路封装

75. 公司主要产品  
75.1 集成电路设计  
75.2 集成电路制造  
75.3 集成电路封装

76. 公司主要业务  
76.1 集成电路设计  
76.2 集成电路制造  
76.3 集成电路封装

77. 公司主要产品  
77.1 集成电路设计  
77.2 集成电路制造  
77.3 集成电路封装

78. 公司主要业务  
78.1 集成电路设计  
78.2 集成电路制造  
78.3 集成电路封装

79. 公司主要产品  
79.1 集成电路设计  
79.2 集成电路制造  
79.3 集成电路封装

80. 公司主要业务  
80.1 集成电路设计  
80.2 集成电路制造  
80.3 集成电路封装

81. 公司主要产品  
81.1 集成电路设计  
81.2 集成电路制造  
81.3 集成电路封装

82. 公司主要业务  
82.1 集成电路设计  
82.2 集成电路制造  
82.3 集成电路封装

83. 公司主要产品  
83.1 集成电路设计  
83.2 集成电路制造  
83.3 集成电路封装

84. 公司主要业务  
84.1 集成电路设计  
84.2 集成电路制造  
84.3 集成电路封装

85. 公司主要产品  
85.1 集成电路设计  
85.2 集成电路制造  
85.3 集成电路封装

86. 公司主要业务  
86.1 集成电路设计  
86.2 集成电路制造  
86.3 集成电路封装

87. 公司主要产品  
87.1 集成电路设计  
87.2 集成电路制造  
87.3 集成电路封装

88. 公司主要业务  
88.1 集成电路设计  
88.2 集成电路制造  
88.3 集成电路封装

89. 公司主要产品  
89.1 集成电路设计  
89.2 集成电路制造  
89.3 集成电路封装

90. 公司主要业务  
90.1 集成电路设计  
90.2 集成电路制造  
90.3 集成电路封装

91. 公司主要产品  
91.1 集成电路设计  
91.2 集成电路制造  
91.3 集成电路封装

92. 公司主要业务  
92.1 集成电路设计  
92.2 集成电路制造  
92.3 集成电路封装

93. 公司主要产品  
93.1 集成电路设计  
93.2 集成电路制造  
93.3 集成电路封装

94. 公司主要业务  
94.1 集成电路设计  
94.2 集成电路制造  
94.3 集成电路封装

95. 公司主要产品  
95.1 集成电路设计  
95.2 集成电路制造  
95.3 集成电路封装

96. 公司主要业务  
96.1 集成电路设计  
96.2 集成电路制造  
96.3 集成电路封装

97. 公司主要产品  
97.1 集成电路设计  
97.2 集成电路制造  
97.3 集成电路封装

98. 公司主要业务  
98.1 集成电路设计  
98.2 集成电路制造  
98.3 集成电路封装

99. 公司主要产品  
99.1 集成电路设计  
99.2 集成电路制造  
99.3 集成电路封装

100. 公司主要业务  
100.1 集成电路设计  
100.2 集成电路制造  
100.3 集成电路封装

101. 公司主要产品  
101.1 集成电路设计  
101.2 集成电路制造  
101.3 集成电路封装

102. 公司主要业务  
102.1 集成电路设计  
102.2 集成电路制造  
102.3 集成电路封装

103. 公司主要产品  
103.1 集成电路设计  
103.2 集成电路制造  
103.3 集成电路封装

104. 公司主要业务  
104.1 集成电路设计  
104.2 集成电路制造  
104.3 集成电路封装

105. 公司主要产品  
105.1 集成电路设计  
105.2 集成电路制造  
105.3 集成电路封装

106. 公司主要业务  
106.1 集成电路设计  
106.2 集成电路制造  
106.3 集成电路封装

107. 公司主要产品  
107.1 集成电路设计  
107.2 集成电路制造  
107.3 集成电路封装

108. 公司主要业务  
108.1 集成电路设计  
108.2 集成电路制造  
108.3 集成电路封装

109. 公司主要产品  
109.1 集成电路设计  
109.2 集成电路制造  
109.3 集成电路封装

110. 公司主要业务  
110.1 集成电路设计  
110.2 集成电路制造  
110.3 集成电路封装

111. 公司主要产品  
111.1 集成电路设计  
111.2 集成电路制造  
111.3 集成电路封装

112. 公司主要业务  
112.1 集成电路设计  
112.2 集成电路制造  
112.3 集成电路封装

113. 公司主要产品  
113.1 集成电路设计  
113.2 集成电路制造  
113.3 集成电路封装

114. 公司主要业务  
114.1 集成电路设计  
114.2 集成电路制造  
114.3 集成电路封装

115. 公司主要产品  
115.1 集成电路设计  
115.2 集成电路制造  
115.3 集成电路封装

116. 公司主要业务  
116.1 集成电路设计  
116.2 集成电路制造  
116.3 集成电路封装

117. 公司主要产品  
117.1 集成电路设计  
117.2 集成电路制造  
117.3 集成电路封装

118. 公司主要业务  
118.1 集成电路设计  
118.2 集成电路制造  
118.3 集成电路封装

119. 公司主要产品  
119.1 集成电路设计  
119.2 集成电路制造  
119.3 集成电路封装

120. 公司主要业务  
120.1 集成电路设计  
120.2 集成电路制造  
120.3 集成电路封装